

展示No.18	区分	部品	素材/材料	設備/装置	金型/治工具	システム/ソフトウェア	その他
提案名	人工衛星部品技術を応用したメタルガスケットで、シール性向上及び軽量化を実現。			工法	薄箔バリ無し打抜き	新規性	該当部品初適用
会社名	(株)日伸精工			所在地	〒351-0001 埼玉県朝霞市上内間木350-3		
連絡先	部署名：営業部 担当名：内田 潔			URL	http://www.nisshin-seiko.co.jp		
				Tel No.	048-456-1188		
				E-mail	k.uchida@nisshin-seiko.co.jp		
主要取引先	<ul style="list-style-type: none"> 株式会社豊田自動織機 日清紡マイクロデバイス株式会社 本田技研工業株式会社 他			海外対応	<input type="checkbox"/> 可 [生産拠点国] <input checked="" type="checkbox"/> 否		

提案内容

提案の狙い		適用可能な製品 / 分野			
<input type="checkbox"/> 原価低減 <input checked="" type="checkbox"/> 品質/性能向上 <input type="checkbox"/> 質量低減 <input type="checkbox"/> 安全/環境対策 <input type="checkbox"/> 生産（作業）性向上 <input type="checkbox"/> その他（ ）		薄箔バリ無し打抜き全般			
従来		新技術・新工法			
◆当該製品に於いて、量産実績で最も薄い製品は0.06t。 ◆密着性向上を図る為、どこまで薄くできるかという要望有。 		◆人口衛星の電極回路に使用する金属箔を、静電気を排除してプレス加工する技術を駆使する事で、0.06tを極限まで薄く（0.02t）打抜く製法を確立。 ◆順送プレス精密加工のバリエーションとして、0.02tの極薄打抜き加工が可能である事の提案。 			
セールスポイント（製造可能な精度 / 材質等）		問題点（課題）と対応方法			
◆SUS材のみならず、アルミや銅に加え、樹脂フィルム等でも対応可能。 ◆ガスケットのみならず、他の分野にも展開可能。		◆製品の梱包及びハンドリング等。			
開発進捗（2022年10月現在）			パテント有無		
<input type="checkbox"/> アイデア, <input checked="" type="checkbox"/> 試作/実験, <input type="checkbox"/> 開発完了, <input type="checkbox"/> 製品化完了（採用： <input type="checkbox"/> 実績有, <input type="checkbox"/> 予定有, <input type="checkbox"/> 予定無）			無		
従来との比較	項目	コスト	質量	生産/作業性	その他
	数値割合	—	1/2以下	—	—